

説明

ウェーハから電子回路を
ICチップ状に切り出す

從晶圓將電子回路以IC晶
片形式切出

日文 ダイシング

(中文) 切割

説明

振動や衝撃、水分やほこり
などの影響による不良を防
止する為にICチップを外界
の影響から遮断し、保護す
る

為防止受到振動、衝擊、水
分及灰塵等影響，保護IC晶
片免受外界影響

日文 パッケージング

(中文) 封裝(package)

將切割出來的晶圓製造IC晶片，並固
定於框架的製程

後行程

出来上がったウェーハを切り出して
ICチップを作り、フレームに固定す
る工程

後段製程

日文 ICチップ

(中文) IC晶片

日文

最終検査

(中文) 最後検査

関連技術

- ダイシング
- 切割
- ワイヤーボンディング
- 打線接合
- モールドイング(封止工程)
- 封裝 (molding)
- 最終検査
- 最後検査

説明

電気特性試験や外観検査な
どの品質検査を行い、不良
品を取り除くこと

實施電気特性試験及外観檢
査等品質検査，排除不良品

解説

- ワイヤーボンディング (打線接合)

チップ上に設けられた電極と外部引き出し用リードフレームを電氣的に接続する。

以電氣的連接將晶片上提供的電極與外部引線框。

- リードフレーム (導線架)

半導体パッケージにおいて、半導体チップを支持・固定すると同時に、パッケージから出た複数の外部接続端子「アウターリード」で外部配線と接続する部品。

半導體封裝工程上保持、固定半導體晶片，同時以從封裝出來的複數之外部連接端子「外引腳」連接外部配線。

- モールディング/封止工程 (封止)

ウエハーから切り出されたチップを樹脂で封止する工程。

用樹脂封止從晶圓切下的晶片的工程。

例文

薄膜形成とは、ウェーハの表面に様々な材料の薄膜をつけるプロセスである。

薄膜形成指在晶圓表面上形成各個材料之薄膜程序。

相關單詞

薄膜形成	薄膜形成	材料	材料
ウェーハ	晶圓	プロセス	程序